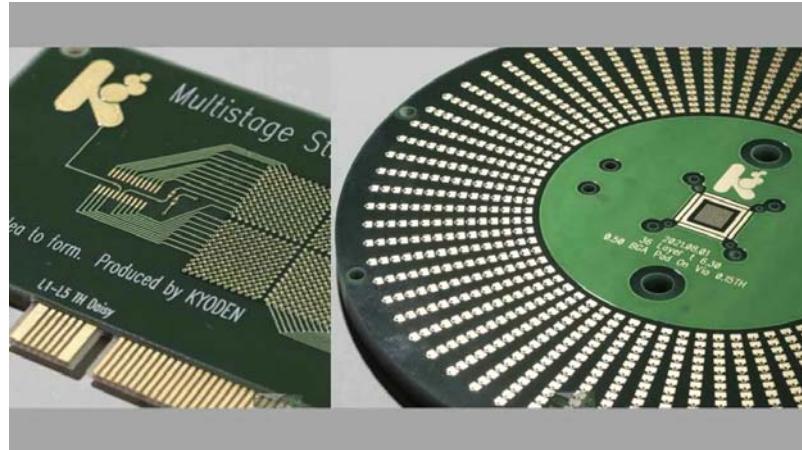


注目銘柄

7カ月で中計上方修正、過去最高営業益キヨウデンの戦略

積極増産投資で需要取り込みに邁進

長野 隆一 2022/08/05 06:30



左側が6層の複合導体／厚銅基板で、右側は36層のバーインボード。いずれも高機能基板だ（写真：キヨウデン提供）

昨年発表したばかりの中期経営計画をわずか7カ月で更新した会社がある。産業機器を中心に設計開発から実装・組み立てまで一貫体制で行うプリント配線基板大手のキヨウデン（6881）がその会社だ。

プリント配線基板など電子事業のほかに、グラスファイバー原料や耐火物、混和材など工業材料事業も展開している。工業材料事業は売上高、利益ともに、全体の2割程度で、主力は電子事業だ。

2021年11月に5カ年の中期経営計画を発表したが、初年度の2022年3月期業績が計画を大幅に超過したため、今年6月に計画更新に踏み切った。

わずか7カ月で中計数値を引き上げた背景

5月に発表した前2022年3月期決算は、期中に2度の上方修正を経て、売上高573億5800万円（前々期比22%増）、営業利益50億9600万円（同2.2倍）で着地した。中期計画初年度のみならず、2年目である2023年3月期の営業利益目標47億円も軽く突破した。

半導体製造装置、産業用ロボット、EV（電気自動車）車向け関連製造装置を含む産業機械を中心に、5G、IoT関連機器や監視カメラといったセキュリティ系などインフラ関連、パワー半導体関連の受注が急拡大。タイ工場も車載用が伸長し、事務機器も伸びた。

顧客の試作開発ニーズが高まっていることが、業績好調の背景にある。2021年半ば以降、半導体不足対策として代替部品による設計変更が急増した。今後も5G、6Gに向かって高周波、高集積、高放熱基板の開発需要が高まる見通しである。

森清隆社長は「5G、IoT関連製品の普及が予想以上のスピードで進み、それらの機器に欠かせないビルドアップ基板の需要も急拡大してきた。このままでは生産が必要に追いつかない。そこで、経営計画の見直しに踏み切った」と語る。具体的には「2026年3月期にはビルドアップ基板の生産能力を5倍に引き上げる計画だ」と続けた。



2018年から当社を率いる森社長(写真:キヨウデン提供)

設備投資額を大幅に引き上げ

設備投資の累計額は、当初の235億円（うち電子事業229億円）から418億円（同383億円）と、1.8倍に引き上げた。この積極投資は自己資金と借入金で賄う。

■設備投資額の計画

	前計画（うち電子事業）	新計画（うち電子事業）
22年3月期	67（66）	44（43）
23年3月期	77（75）	140（137）
24年3月期	60（59）	85（84）
25年3月期	22（21）	80（78）
26年3月期	9（8）	69（41）
累計	235（229）	418（383）

(注) 単位は億円

(出所) 会社の資料を基に東洋経済作成

SHIKIHO ONLINE

設備投資の具体的な内容だが、森社長は「最大の狙いは国内工場の設備増強による増産体制と生産性改善である。加えて、EMS（受託生産）事業の強化」と言う。

大阪、東京、東北の3工場は、ロボットや自動搬送機などマテハン機器（部品や製品の移送に使う機器）の増設による省力を進め、生産性の向上を図る。また、長野工場、大阪工場のビルドアップ基板生産ラインの増設も順調に進み、長野工場が今年の8月中旬、大阪工場は同10月から増産体制に入る。

EMS事業では、和歌山県紀の川工場を新設する。ここはプリント基板実装工場で、2023年4月に稼働予定だ。静岡県狩野川工場は第1期拡張工事が完了し、今年の11月稼働を開始する。第2期工事も進めており、こちらは2024年10月稼働予定だ。

これらの施策で、箱やケース部品を製造するメカ事業や、基板に電子部品を搭載する実装事業、そして組み立てて最終製品にするユニット事業を増強する。メカ事業については、板金・プレス・成形の増産計画に加え、新たに切削・塗装部門も新設した。

海外事業でも、すでにあるタイ工場内に新たな工場を設ける。同工場に取得済みの土地に130億円（中期計画内で80億円）を投じ、EV化、電装化により大幅な需要増が見込まれる多層基板の生産を拡充する。2024年1月からの稼働を予定し、生産体制は現在の月産3万平方メートルから6万平方メートルに倍増する計画だ。

こうした積極的設備投資により、業績も大幅な向上を見込んでいる。計画2年目の今2023年3月期も売上高650億円（前期比13.3%増）、営業利益58億円（13.8%増）と連続増益の計画。そして、計画最終年度の2026年3月期は売上高942億円（電子事業782億円）、定率法を採用しているため減価償却負担も軽くなり、営業利益は125億円（同113億円）を目標にしている。

■更新後の中期経営計画

	売上高	営業利益
22年3月期	573	50
23年3月期	650	58
24年3月期	741	63
25年3月期	850	96
26年3月期	942	125

(注) 単位は億円

(出所) 会社の資料を基に東洋経済作成

SHIKIHO ONLINE

新計画達成の力を握る最先端技術

もう一つ、中計の根幹をなすのが最先端技術の開発だ。2021年には、高速厚銅めっき工法による高放熱基板を開発した。5G基地局用パワー・アンプやパワー半導体の効率的な放熱対策が求められるなか、従来製品では放熱特性や高周波特性が不十分で、量産性や基板の信頼性が欠けていた。これに加え、薄板対応も困難であった。

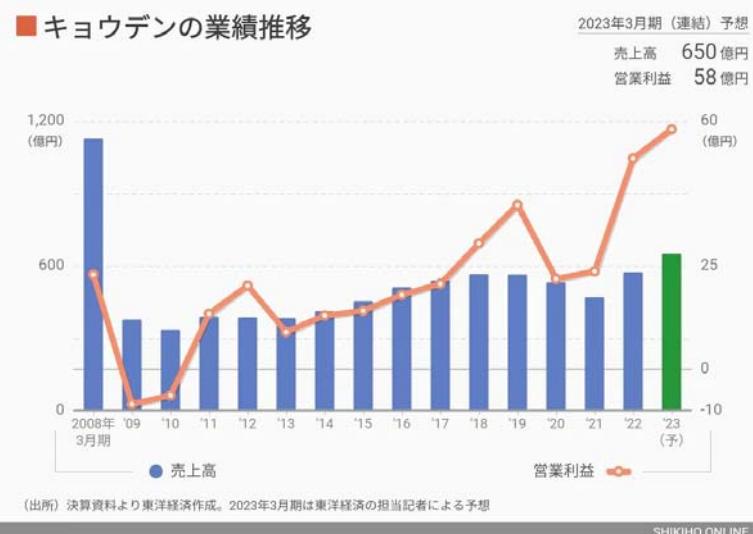
こうした課題を解決したのが新技術である。熱伝導の高い銅でダイレクトに基板下部に接続放熱される。薄板基板やビルドアップ層構成でも対応可能になった。「高放熱基板はさらなる放電、高周波の要求に対応するため、素材と工法を組み合わせて顧客の要求に応えられるビルドアップ基板の生産が可能になったことが当社の強みだ」と森社長は強調する。

高密度基板実装から大型部品実装まで対応できることや、業界最速レベルでの短納期、また開発から海外量産やEMSまですべてグループ内の完全内製化で対応できる点なども当社の特徴だ。足元では営業力や開発体制を強化するため、人員増員にも積極的に取り組んでいる。

懸念材料もある。円安や原油高騰による原料、資材、電力費用のさらなる値上げ圧力、半導体不足による顧客の生産調整や在庫調整などだ。半導体不足を起因に生産増強が遅延することなども考えられる。ただ、「タイからの輸出が主で、全体的に製品の輸出入が少なく、円安の影響はほとんどない。資材高については適正利益を確保するため、製品転嫁をお客さんに了承していただくことを前提にしている」(森社長)という。

すでに述べた高多層やビルドアップ基板など高付加価値製品拡販による収益性追求、さらに最新設備導入による生産性向上、先行手配による資材確保など、地道な積み重ねが確実に浸透すれば、新規経営計画達成は十分可能といえよう。

(東洋経済 記者)



許諾番号：2022-078（掲載日より1年間有効）

「会社四季報オンライン」2022年8月5日掲載

©東洋経済新報社 無断複写転載を禁じます。